



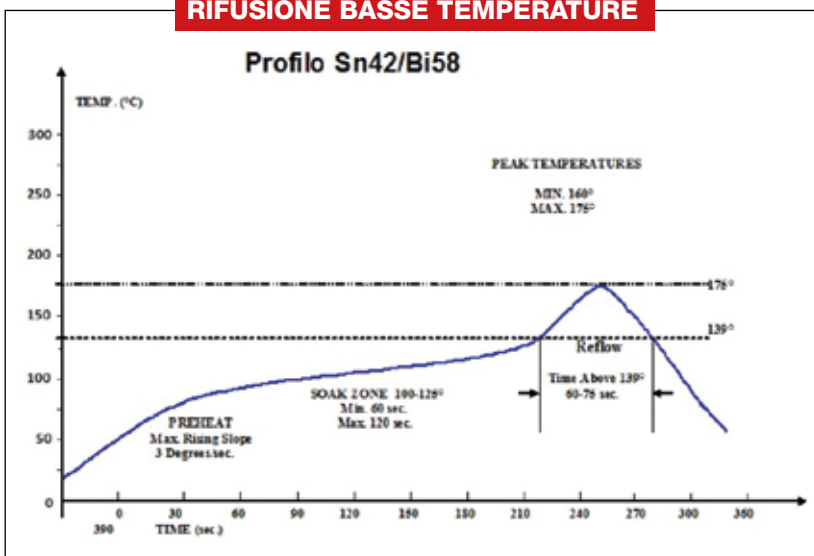
## CREME SALDANTI

- Garanzia di massima flessibilità con un'ampia finestra di processo
- Eccellente bagnabilità
- Stampabilità anche su passi molto ridotti
- Giunti lucidi
- Massima resistenza all'effetto "slump"
- Utilizzabile sia per rifusione in ambiente aria che azoto
- Percentuale minima di void nei giunti BGA
- Vita sullo stencil fino a 8 ore
- Tempo di inattività fino a 120 minuti
- Tack time fino a 24 ore
- Velocità di stampa fino a 200 mm/sec
- Residui trasparenti minimi e non conduttivi

Lead Free process	NC 825 SAC305 Sn96,5Ag3Cu0,5	NC 818 Stagno/Bismuto Sn58Bi42
Leaded process	NC 818 SN62 Sn62Ag2Pb36	



### RIFUSIONE BASSE TEMPERATURE





## FILI SALDANTI

I fili saldanti **Qualitek NC601** contengono un attivatore molto efficace, che garantisce alta bagnabilità e diffusione. I residui post-saldatura sono limitati e possono essere spazzolati. Disponibile nei diametri 0,5, 0,7 e 1 mm, con percentuale di fluxante di 1,1% e 2,2%.

- SAC 305 (SnAg3,0Cu0,5)
- SN100 (SnCuNi)
- Stagno-Piombo (Sn60Pb40)

## PEELABLE SOLDER MASK



**Ceasolder-AL** è una maschera di lattice acrilico temporanea, progettata per la protezione di aree selezionate durante il processo di assemblaggio per la saldatura a onda, reflow o hot-air solder leveling. Non contenendo ammoniacca non è quindi corrosivo su circuiti con finiture in rame, oro e argento. Di facile applicazione e rapida asciugatura, **Ceasolder-AL**, quando applicato, si presenta di colore rosa e dopo la saldatura diventa rosso e di facile asportazione, non lasciando alcun residuo. Disponibile in flaconi da 250 grammi.

- Facilmente rimovibile
- No ammoniacca
- Non infiammabile
- Ecologico
- Odore gradevole
- V.O.C.-free